(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年10月2日(02.10.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/204649 A1

(51) 国際特許分類:
B23Q 3/08 (2006.01) *B24B 41/06* (2012.01)
B24B 7/17 (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/008046

(22) 国際出願日： 2025年3月5日(05.03.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-057254 2024年3月29日(29.03.2024) JP

(71) 出願人: 株式会社レゾナック・ハードディスク(**RESONAC HARD DISK CORP.**) [JP/JP]; 〒2900067 千葉県市原市八幡海岸通５番地１ (JP).

(72) 発明者: 久志野 高宏 (**KUSHINO, Takahiro**); 〒3238678 栃木県小山市犬塚１丁目４８０番地 株式会社レゾナック・ハードディスク内 (JP). 間舘 秀雄(**MADATE, Hideo**); 〒3238678 栃木県小山市犬塚１丁目４８０番地 株式会社レゾナック・ハードディスク内 (JP).

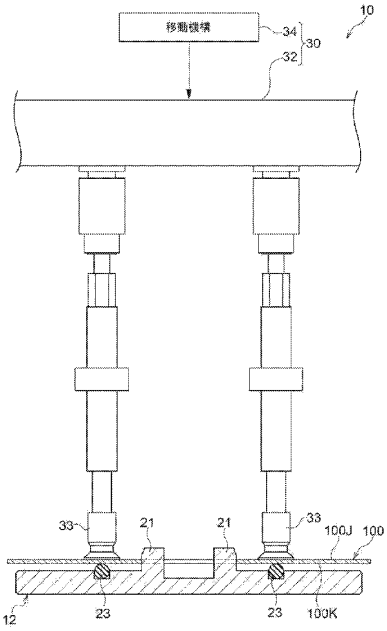
(74) 代理人: 弁理士法人太陽国際特許事務所(**TAIYO, NAKAJIMA & KATO**); 〒1600022 東京都新宿区新宿４丁目３番１７号 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,

(54) **Title:** METHOD FOR MANUFACTURING DISK-SHAPED SUBSTRATE, AND APPARATUS FOR MANUFACTURING DISK-SHAPED SUBSTRATE

(54) 発明の名称： 円盤状基板の製造方法、及び円盤状基板の製造装置

[図4]



34 Movement mechanism

(57) **Abstract:** This method for manufacturing a disk-shaped substrate includes: a support step of supporting a disk-shaped substrate by a support part at a first position on one surface of the disk-shaped substrate; a conveyance step of adsorbing the disk-shaped substrate at a second position on the other surface of the disk-shaped substrate, which faces the first position, by an adsorption part, and conveying the disk-shaped substrate onto a table of a processing apparatus while maintaining a state in which the adsorption part adsorbs the other surface; and a processing step of processing the disk-shaped substrate

WO 2025/204649 A1

［続葉有］

CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国（表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能）：ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）

conveyed onto the table.

(57) 要約：円盤状基板の製造方法は、円盤状基板の一方の面上の第一位置にて、当該円盤状基板を支持部で支持する支持工程と、前記第一位置に対向する前記円盤状基板の他方の面上の第二位置にて、当該円盤状基板を吸着部で吸着し、当該吸着部が前記他方の面を吸着した状態にて、当該円盤状基板を加工装置の台上に搬送する搬送工程と、前記台上に搬送された前記円盤状基板に対して加工を行う加工工程と、を備える。